

References

References

REFERENCES

- 1- B. Voit, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.* 2000; **38**: 2505.
- 2- S. Rannard, N. Davis, *Polym Master Sci. Eng.* 2001; **84**: 2.
- 3- A. Blencowe, L. Davidson, W. Hayes., *J. European Polym.* 2003; **39**: 1955.
- 4- Y.H. Kim, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.* 1998; **36**: 1685.
- 5- N. James, H. Bing, A. Georgia, K. Arbuckle, *Synthetic Metals* 2005; **149**: 63.
- 6- B. Bogdanow, A. Vidts, A. Van Den Bulckep, R. Verbeeck, E. Schacht., *J. Polym. Sci.* 1998; **39**: 8.
- 7- Y. He-Ping, L. Si-Dong, Z. Jic-Ping, X. Kw., *Thermochim Acta* 2004; **410**: 119.
- 8- S.Y. Tawfik, *J. Appl. Polym. Sci.* 2001; **81**: 3388.
- 9- N. Sombatsompop, K. Sungsan, *Polym. Eng. Sci.* 2004; **44**: 487.
- 10- Y.F. Shih, Y.T. Wang, R.J. Jeng, K.M. Wei, *Polym. Degrad. Stab.* 2004; **86**: 399.
- 11- V. Mamleev, S.J. Bourbigot, *Thermal Anal. Cal.* 2002; **70**: 565.
- 12- C.D. Gamlin, N.K. Dutta, N.R. Choudhury, D. Kehoe, J. Matisons, *Thermochemical Acta* 2002; **357**: 392.
- 13- M. Lewin, *Polym. Adv. Technol.* 2001; **12**: 215.
- 14- Y.A. Demchenko, A. Razina, Z. Sedláková, A. Sikora, J. Baldrian, M. Ilavsky, *J. European Polym.* 2002; **38**: 2333.

-
- 15- S. Kordestanis, S. Hanna, A.H. Windle, *Polymer* 2000; **4**: 6619.
 - 16- G. Rambert, J. Grandidien, *J. European of Mechanics A/ Solids* 2005; **24**: 151.
 - 17- A. Pich, S. Bhattacharya, H. Adler, *J. Polymer.* 2005; **46**: 1079.
 - 18- W. Chen, A.G. Joly, J.O. Malm, J.O. Bovin, S. Wang, *J. Phys. Chem. B.* 2003; **107**: 6544.
 - 19- K.R. Powell, T. McCleskey, W. Tumas, J.M. De Simone, *Ind. Eng. Chem. Res.* 2001; **40**: 1301.
 - 20- S.M. Scholz, R. Vacassy, J. Dutta, H. Hofmann, M. Akinc, *J. Appl. Phys.* 1998; **83**: 7860.
 - 21- A. Pich, J. Hain, Y. Prots, H. Adler, *Polymer* 2005; **46**: 7931.
 - 22- D.A. Colling, T. Vasiolos. "*Poly, Cermaics, Composite*" 1995; **2**.
 - 23- D. Horak, *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 2001; **39**: 3707.
 - 24- R. Naik, E. Eroll, D. Rodank, G.M. Tsoi, E. McCullen, L.E. Wenger, R. Suryanarayanan, V.M. Naik, P.P. Vaishnava, Q. Tao, P. Bool Chand, *J. Magn. Mater* 2004; **272**: 1239.
 - 25- L.C. Santa Maria, M.C.A.M. Leite, M.A.S. Costa, J.M.S. Ribeiro, L.F. Senna, M.R. Silva, *J. European Polym.* 2003; **39**: 843.
 - 26- C. Martin, L. Ramirez, J. Cuellar, *Surf. Coat. Technol.* 2003; **165**: 58.
 - 27- A. Peutzfeldt, A. Sahafi, E. Asmussen, *Dent. Material.* 2000; **16**: 330.

-
-
- 28- M. Latta, C. Stanislav, W. Barkmeier, *J. Dent. Res.* 2000; **79**: 333.
- 29- F. Stahl, S.H. Ashworth, K.D. Jandt, R.W. Mills, *Biomaterials* 2000; **21**: 1379.
- 30- L. Musanje, B.W. Darvell., *Dent. Material* 2003; **19**: 531.
- 31- M.C. Burl, B.C. Sisk, T.P. Vaid, N.S. Lewis, *Sens. Actutors B.* 2002; **87**: 130.
- 32- H. Lei, W.G. Pitt, L.K. McGrath, C.K. Ho, *Sens. Actutors B.* 2004; **101**: 122.
- 33- L. Quercia, F. Loffredo, B. Alfano, V. La Ferrara, G. Di Francia., *Sens. Actuators B* 2004; **100**: 22.
- 34- B. Philip, J.K. Abraham, A. Chand Rasekhar, V.K. Varadan, *Smart. Mater. Struct.* 2003; **12**: 935.
- 35- L. Quercia, F. Loffredo, G. Difran Cia., *Sens. Actuators B* 2005; **109**: 153.
- 36- A. Rouilly, L. Rigal, *J. Macromol Sci. Polym. Rev.* 2002; **C42**: 491.
- 37- H.M. Wilhelm, M.R. Sierakowski, G.P. Souza, F. Wypych, *Carbohydr. Polym.* 2003; **52**: 101.
- 38- P.C. Oliveira, A. Guimaraes, J.Y. Cavaille, L. Chazeau, R.G. Gilbert, A.M. Santos, *Polymer.* 2004; **2**: 518.
- 39- C. Nakason, A. Kaesaman, W. Sainamsai, W.S. Kiatkamjon, *Polymer Test.* 2002; **21**: 449.
- 40- C. Nakason, A. Kaesaman, A. Rungvichaniwat, K. Eardrod, W. S. Kiatkamjon, *J. Appl. Polym. Sci.* 2003; **89**: 1453.
- 41- A. Rouilly, L. Rigal, R.G. Gilbert., *Polymer* 2004; **45**: 7813.
-
-

- 42- K. Nair, S. Thomas, G. Groeninck, *Compos. Sci. Technol.* 2001; **61**: 2519.
- 43- D. Ray, B. Sarkar, S. Das, A. Rana, *Compos. Sci. Technol.* 2002; **62**: 911.
- 44- S. H. Aziz, M. P. Ansell, S. J. Clarke, S. R. Panteny., *Compos. Sci. Technol.* 2005; **65**: 525.
- 45- A. Peutzfeldt, A. Sahafi, E. Asmussen, *Dental materials* 2000; **4**: 140.
- 46- G. Danesh, H. Davids, S. Duda, M. Kaup, K. Ott, E. Schafer, *American Journal of Dentistry* 2004; In press.
- 47- R.B. Price, T. Derand, R.W. Loney, P. Andreou, *American Journal of Dentistry* 2002; **15**: 47.
- 48- G. Danesh, H. Davids, K. Reinhardt, K. Ott, E. Schafer., *J. of Dentistry* 2004; **32**: 479.
- 49- E. T., Enikov, G. S. Seo-Sens., *Actuators A*. 2005; **122**: 264.
- 50- X. Bao, Y. Bar-Cohen, S. Lith, EAPAD Conference 2002; 219.
- 51- M. Shahinpoor, K. J. Kim, *Smart Material Struct.* 2004; **13**: 1362.
- 52- G. Nikishkov, *J. Appl. Phys.* 2003; **94**: 5333.
- 53- K.J. Kim, M. Schahinpoor, *Smart Material Struct.* 2003; **12**: 65.
- 54- W.B. Genetti, W.L. Yuan, B.P. Grady, E.A. O'Rear, C. L. Lai, D.T. Glatzhofer, *J. Mate. Sci.* 1998; **33**: 3085.
- 55- B.P. Grady, W.B. Gentti, R.J. Lamirand, M. Shah, *Polym. Eng. Sci.* 2001; **41**: 820.

-
- 56- A.R. West, "*Basic Solid State Chemistry*", John Wiley, Sons, 1987.
- 57- A.M. Polyakov. "*Semiconductors Made Sample*", Mir Publishers: 1985.
- 58- M. Siekierski, K. Nadara, *Electrochim. Acta* 2005; **50**: 3796.
- 59- A. Aabloo, J. Thomas, *Solid State Ionics* 2001; **143**: 83.
- 60- C. Xu, P.M. Hui, Z. Y. Li, *J. Appl. Phys.* 2001; **90**: 365.
- 61- J. Vilcakova, P. Saha, V. Kresalek, O. Quadart., *Synthetic Metals* 2000; **113**: 83.
- 62- A. Arbelaiz, G. Cantero, B. Fernandez, P. Ganan, J.M. Kenny, I. Mondragon, *Polym. Compos.* 2005; **26**: 329.
- 63- J. Biagiotti, D. Puglia, L. Torre, J.M. Kenny, A. Arbelaiz, *Polym. Compos.* 2004; **25**: 470.
- 64- M.M. Thwc, K. Liao, *Compos. Sci. Technol.* 2003; **63**: 375.
- 65- T.H.D. Sydenstricker, S. Mochnaz, Sc. Amico., *Polym. Test* 2003; **22**: 375.
- 66- Y. Li, Y. Mai, L. Ye, *Compos. Sci. Technol.* 2001; **60**: 2037.
- 67- M.J.A. Van den Oever, H.L. Bose, *Appl. Compos. Mater.* 2000; **7**: 387.
- 68- G. Cantero, A. Arbelaiz, L. Ponte, *Compos. Sci. Technol.* 2003; **63**: 1297.
- 69- M. Z. Raman, *Singh-Materials Letters* 2004; **58**: 408.
- 70- A. A. Inamuddin, M. M. Alam., *Mat. Research Bulletin* 2005; **40**: 289.
- 71- Z.F. Li, E. Ruckenstein, *Langmuir* 2002; **18**: 6956.
- 72- A.P. Gupta, S. Ikram, H. Agarwal, *J. Sci. Ind. Res.* 2002; **13**: 245.
-

-
- 73- F. Beleze, J.G. Zarbin, *J. Braz. Chem. Soc.* 2001; **12**; 542.
- 74- J. Simitzis, L. Zoumpoulakis, S. Soulis, *J. Polym. Int.* 2002; **51**: 297.
- 75- Y. Yum, S. Lee, K. Lee, Y. Lee, J. DoNam, *J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys.* 1997; **35**: 2447.
- 76- S. Jinpark, J. S. Jin, *J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys.* 2003; **41**: 55.
- 77- N. Suzuki, M. Lto, S. Ono., *J. Appl. Polym. Sci.* 2005; **95**: 74.
- 78- A. Nagatani, T. Endo, T. Hirotsu, M. Furukawa, *J. Appl. Polym. Sci.* 2005; **95**: 144.
- 79- C.T. Sun, C. Han, *J. Compos. B. Eng.* 2004; **35**: 647.
- 80- A. Larena, S. Jimenez de Ochoa, *J. Appl. Surf. Sci.* 2004; **238**: 530.
- 81- J. Tsai, C.T. Sun, *Int. J. Solids, Structure* 2004; **41**: 3211.
- 82- G. H. Kim, *Compos. Sci. Tech.* 2005; **65**: 1728.
- 83- O.L.S. Alsina, L.H. de Carvalho, F.G. Ramos Filho, J.R.M. d'Almeida, *Polym. Testin*, 2005; **24**: 81.
- 84- G. B. Kharas, M. K. Sky, J. Simanti-raki, K. C. Beinlich, A. M. T. Rizzo, *J. Appl. Polym. Sci.* 1998; **66**: 1123.
- 85- J. Vilcakova, P. Saha, O. Quadrat, *J. European Polym.* 2002; **38**: 2343.
- 86- M. Siekierski, P. Rzeszotarski, K. Nadara, *Solid State Ionics* 2005; **176** : 2129.
- 87- M.G. Abd El-Wahed, S.M. Metwally, *Material Letters* 1994; **20**: 231.
-

- 88- A. Ovenstonj, T.R. Walls, S. Miri, T. Rapideen, *J. Appl. Phys.* 1988; **21**: 1773.
- 89- S.R. Elliot, *Adv. Phys.* 1987; **36**: 135.
- 90- G. Spathis, E. Kontou, V. Kefalas, L. Apekis, Christodulides, P. Pissis, M. Olivon, S. Quinavent, *J. Marcond, Sci. Phys.*, D 1990; **29**: 31.
- 91- K.C. Kao and W. Hwang, *Elect. Transp. In Solids* 1981.
- 92- V.Z. Barsukov, V.G. Khomenko, S.V. Chivikov, I.V. Barsukov, T.I. Motronyuk, *Elect. Acta* 2001; **46**: 4083.
- 93- L.L. Apekis, P. Pissis and C. Chistodoulides, Proc. 6th Int. Symp. Electricity IEEE Service Center, Picatway, N.J., USA 1998; 28.